

公司代码：688300

公司简称：联瑞新材

**江苏联瑞新材料股份有限公司**  
**2025年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2、 重大风险提示

公司可能面临的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

### 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），拟派发现金红利总额为人民币12,073.46万元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的41.26%。公司本年度不送红股、不转增股本。上述2025年度利润分配方案按公司2025年年度报告披露日公司总股本241,469,190股计算。

上述利润分配方案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需经公司2025年年度股东会审议通过后实施。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1、公司简介

#### 1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	联瑞新材	688300	不适用

#### 1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

#### 1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柏林	李欣安
联系地址	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区
电话	0518-85703939	0518-85703939
传真	0518-85946111	0518-85946111
电子信箱	novoinfo@novoray.com	novoinfo@novoray.com

### 2、报告期公司主要业务简介

#### 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

##### 1、主要业务

公司致力于功能性填料行业产品的研发、制造和销售，开展功能性先进粉体材料的研发和制造技术、超微粒子的分散技术、超微粒子的填充排列技术以及超微粒子的表面处理技术为基础的新材料、新技术、新工艺和新应用的研究。

##### 2、主要产品

公司主要产品为功能性先进粉体材料，涵盖微米级和亚微米级角形粉体、微米级至纳米级球形粉体以及其他超微粒子和液态填料等，具有高纯度、高绝缘、低线性膨胀系数、高导热性、低介电损耗、低放射性等特点。产品广泛应用于芯片封装用环氧塑封材料(EMC)、液态塑封材料(LMC)、颗粒状环氧塑封材料(GMC)、底部填充材料(UF)、电子电路板(CCL)、积层胶膜(BF)、导热材料、特种胶黏剂、蜂窝陶瓷载体以及特高压电力电子制品、3D打印材料、齿科材料等新兴业务。

##### 3、服务情况

公司致力于成为全球领先的功能性先进粉体材料及应用方案供应商，在“陪你做填料艺术家”愿景的指引下，紧紧围绕行业发展趋势，战略性配合国内外行业领先客户。公司产品销售至行业领先的EMC、LMC、GMC、UF等封装材料、电子电路板、导热材料、胶黏剂、先进绝缘制品、蜂窝陶瓷、3D打印、齿科材料等领域客户，品牌影响力显著提升。公司不仅在传统产品质量方面赢得国内外领先客户认可，而且微米级和亚微米级球形二氧化硅、低放射性球形二氧化硅、低放射性高纯度球形氧化铝、球形二氧化钛、氮化物等产品销售至行业领先客户。公司产品除了在中国大陆销售以外，还在日本、韩国、欧美、东南亚、中国台湾等国家和地区实现销售，公司和诸多国内外知名企业建立了紧密的合作关系。

#### 2.2 主要经营模式

**研发模式：**公司始终高度重视研发工作，坚持以客户需求为导向开展研发。在公司层面设立

技术委员会把握公司产品规划和技术方向。技术中心面向新技术、新材料、新应用；工艺部面向新性能、新工艺、新装备；品质管理部负责及时全方位识别客户需求，为客户提供综合解决方案。重视自主创新和产学研用合作创新相结合。

**采购模式：**公司通过科学管理制度保障采购目标及效率。制度上以质量管理体系为核心，完善供应商导入与持续改善机制，质量管控前移，与供应商建立价值共创伙伴关系，由供应链部统一管理。采用以销定购模式，按订单采购并储备合理库存。严格审核供应商规模、供应半径、反应时间、质量保证、环境安全及资信，编制合格名录并定期评价建档，价格和数量随市场价格和订单而定。

**生产模式：**公司围绕“及时提供满足顾客要求的产品和服务并持续改进”的质量方针，坚持使用行业一流的设备制造产品、注重现场管理的持续改善、长抓不懈推动员工素养提升、始终保持质量上的高标准，建设了行业一流的智能化生产线，已通过 ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001 认证。采取“以销定产”的生产模式，公司提前对接下游客户的应用需求，根据客户需求规划设计产品，使之适应不同行业甚至不同客户的需求，为客户提供性能优异的产品，以此与客户建立长期稳定的信赖合作关系。

**销售模式：**公司采用直销为主、代理为辅的销售模式。公司始终坚持以客户需求为导向，快速响应客户需求，持续优化配置资源服务客户，针对不同领域客户的需求，设计、建立专业化的技术服务和营销队伍，让客户第一时间准确了解公司和产品，快速准确识别客户需求并提供定制化产品和整体解决方案。公司已形成专业、规范、有序、完善的营销体系。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，在日常的生产经营中，下游客户向公司提交订单，经公司确认后按订单的具体要求进行发货销售。

## 2.3 所处行业情况

### (1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### 1.1 行业的发展阶段

公司产品属于新材料行业。新材料行业是国民经济的战略性、先导性产业，对我国由制造大国向制造强国转变具有重要的战略意义。新材料行业的科技创新是赋能各行业科技创新、转型升级、高质量发展的基础，是培育新质生产力的关键领域。根据工信部，2024 年新材料产业总产值预计突破 8 万亿元，2025 年预计将达到 10 万亿元。在新旧动能转化、产业结构升级的大背景下，人工智能、高速通信、航空航天、新能源等领域等各应用领域的快速发展为新材料的技术研发和推广应用提供了巨大的推动力，作为新材料的硅基氧化物和铝基氧化物等功能性先进粉体材料得到了越来越多的市场机遇，产业链上下游联系愈发紧密，多学科、多部门合作进一步加强，核心技术不断突破，产品类别不断丰富，未来市场前景广阔。

##### 1.1.1 半导体封装材料行业

半导体封装是半导体制造的后道工艺，其核心任务是在晶圆完成前道制程后，将其封装为具备完整功能的独立芯片，封装工艺不仅要实现芯片与外部电路之间的电气连接与机械保护，还需确保芯片在复杂工作环境下的可靠性。以引线键合等为代表的传统封装技术，通过将芯片固定于基板并实现引脚连接，满足了保护、连接等基本应用需求；先进封装通过多芯片集成、高密度互连、异构封装等方式，除满足常规的保护、连接外，还可起到提高互联性能、提升功能密度、实现系统重构等作用，成为突破芯片性能瓶颈的关键技术。封装材料位于半导体封装的上游环节，其使用贯穿于整个封装流程，直接影响芯片的封装质量、性能与可靠性。高性能封装材料属于技术含量高、工艺难度大、知识密集型的，是先进封装持续发展的基础。

近年来，以 HPC、AI、高速通信等下游应用的需求为牵引，先进封装技术正进入快速发展阶段。据 Yole 预测，到 2030 年全球先进封装市场规模将增长至约 800 亿美元，2024-2030 年复合年

增长率达到 9.4%。从技术结构来看，先进封装涵盖 WLCSP（晶圆级芯片规模封装）、FCCSP（倒装芯片级封装）、FCBGA（倒装芯片球栅阵列封装）、2.5D 封装、3D 封装以及 SiP（系统级封装）等多种形态。其中，FC（倒装）技术仍是当前占比最大的细分领域，市场份额超 40%。与此同时，受 AI 及高端算力芯片需求的强力驱动，2.5D/3D 等封装技术的市场份额正快速提升，Yole 预计其占比将从 2023 年的 27% 上升至 2029 年的 40%，年均复合增速高达 18.05%，全球先进封装市场正加速向高集成度与异构集成架构演进。在此背景下，先进封装技术对封装材料体系提出了前所未有的升级需求，进而催生出对功能先进粉体材料在大颗粒精准控制、低放射含量、高导热性等方面的系统性升级需求，这一升级需求的变化，深刻改变了填料在先进封装中的角色定位与市场价值，以球形二氧化硅、球形氧化铝等为代表的功能性无机粉体填料正成为决定集成电路封装产业链价值跃升的关键环节，市场空间广阔。

AI 服务器、高速通信设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗、航空航天等行业的不断发展，带动了 EMC、LMC、GMC、Underfill 等封装材料领域的市场需求，进而对于具有更低 CUT 点、更加紧密填充、更低的放射性含量、高导热性的球形二氧化硅、球形氧化铝等功能性先进粉体材料的市场需求。公司依靠核心技术生产的功能性先进粉体材料具有行业领先的电性能、低 CUT 点、高填充率、高纯度等优良特性，持续精准满足新一代芯片封装材料的高性能要求。

### 1.1.2 电子电路基板行业

覆铜板（CCL）是用于制作印刷电路板（PCB）的重要基材，在 PCB 中主要起互连导通、绝缘和支撑的作用，其性能对电路中信号的传输速度、能量损失等具有直接影响。覆铜板种类丰富，按大类分为刚性与挠性，全球市场以刚性覆铜板为主。刚性覆铜板一般分为玻纤布基（常规 FR4、无铅无卤 FR-4、高 Tg FR-4）、纸基（FR-1 等）、复合基（CEM 系列）、特殊材料基（包括高频、高速和封装基板），通过制作成 PCB，应用于下游各类电子产品需求领域。从发展趋势来看，覆铜板呈现高速高频化发展趋势。

目前，AI、高速通讯、高性能算力等应用领域的正快速发展，带动了算力板卡、交换机与光模块等领域的同步升级，下游硬件对于通讯频率、传输速度等方面性能要求不断提升，为满足日益增长的 AI 算力高速数据传输需求，低介电损耗材料应用已成为下游电子电路基板技术发展重要方向，越来越多的电子电路基板厂商已经使用 M4-M6 材料发展至使用 M7-M8 等高速材料，更将向使用 M9、M10 及以上等级持续发展，以确保高速数据传输的稳定性和可靠性，高性能覆铜板正加速渗透。根据 Goldman Sachs Global Investment Research 预计，HDI&高速高频等高阶覆铜板市场 2024-2026 年均复合增长率高达 26%，高性能覆铜板市场需求保持较高景气度。对于覆铜板上游材料而言，需要选择具有较低 Df 的材料以保证在使用过程减少信号传输时的衰减、时延，以提高信号完整性，在功能性填料选择上，对于粒径、介电损耗等性能指标要求更为严格，因此，球形二氧化硅等为代表的高性能填料成为行业主流选择。

公司依托 42 年功能性先进粉体粉体材料的技术积累，突破了高频、高速、HDI、IC 载板等高性能电子电路基板用功能填料的核心技术，产品具有低 Cut 点、低介电损耗、高导热等优良性能，精准满足了高性能覆铜板客户的需求。2025 年销售至高性能覆铜板领域的球形二氧化硅等产品营收占比呈上升趋势。

### 1.1.3 导热材料行业

导热材料是电子元件热管理系统的重要组成部分，通过将电子元件产生的热量迅速、高效地传递至外界，从而提升散热性能，达到降低电子元件工作温度、延长其使用寿命的重要作用。导热材料主要包括导热硅脂、导热凝胶、导热垫片、导热灌封胶、导热相变材料等聚合物基导热材料、金属基导热材料、陶瓷基导热材料、碳基导热材料和其他新型导热材料，下游应用场景主要包括消费电子、通信设备、新能源汽车等领域。

在消费电子领域，由于 AI、高速通讯、大功率快充等技术在手机、PC、穿戴设备等终端设备持续渗透，使得终端设备处理器能力及功耗均不断提升，发热量急剧增加，散热问题成为终端设

备的重要挑战。根据 IDC 预计，2024 年中国市场 AI 手机出货量为 3700 万台，2027 年将达到 1.5 亿台，2024-2027 年 CAGR 为 59.45%。随着相关消费电子终端设备销量持续提升，导热材料作为终端设备的关键散热方案，市场需求空间有望继续扩大。

在通信设备领域，凭借科技创新、市场空间和政策支持，我国通信设备制造业快速发展，已成为全球领先的产业中心，行业规模持续扩展。根据智研咨询数据，我国通信设备制造业市场规模从 2015 年的 16,867.86 亿元增长至 2023 年的 26,347.3 亿元，年均复合增长率达 5.73%。其中，根据 TrendForce 数据，2023 年全球 AI 服务器出货量为 120.5 万台，2026 年有望达 236.9 万台，年均复合增速约 25%，由于 AI 服务器严重依赖高速通信技术来构建集群，实现多台服务器、多个 GPU 之间的高速数据交换和协同计算，AI 等技术的迅速渗透应用发展将带动高速通信设备市场保持增长，导热材料行业也将因此受益。

在新能源汽车领域，导热材料广泛应用于电控模组、驱动电机、动力电池、电源灌封、ADAS 传感器等，导热材料对于各器件稳定、高效、安全的运行起到了关键性作用。根据中汽协数据显示，2025 年我国新能源汽车销量达到 1649 万辆，同比增长 28.2%；同期 EVTank 统计数据显示，全球新能源汽车销量攀升至 2354.2 万辆，同比增幅达 29.1%。随着新能源汽车的渗透率增长和智能化程度提高，新能源汽车领域对导热材料的需求量与日俱增，已成为导热材料的重要增长点。

导热材料基材往往采用高分子材料，而高分子材料导热性能有限，所以通常需要添加热传导率较高的球形氧化铝等材料来改善其热传导性。伴随高性能导热材料的需求日益提升，催生作为导热填料的球形氧化铝、氮化物等市场需求的提高，导热填料的的市场需求及发展前景日趋明显。

#### 1.1.4 新应用领域

随着我国国民经济进入高质量发展新阶段，各类新兴行业对功能性先进粉体材料的需求不断提升。在电力电子领域，特高压、AIDC 等行业的快速发展，为电力电子制品提供了新的发展机遇。新一代电力电子制品不仅需要承受高压输电时超高电压的极限考验，还对电力电子制品的耐气候、极端条件下局放标准、稳定性、环保性、耐老化等性能提出了更高要求，除了聚合物要求提升外，功能性填料的作用也愈加明显，经过特殊颗粒设计的填料在解决电力电子制品在更加恶劣的气候环境中强度提升、局放降低等方面效果显著。在 3D 打印材料、齿科材料等领域，微米级、亚微米级、纳米级球形二氧化硅凭借合理的粒度分布、低比表面积、高流动性、适宜的光学特性等特点，大幅度地提升相关制品的性能，功能性先进粉体材料应用领域进一步拓展。

## (2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是功能性先进粉体材料领域的领先企业，依托四十余年持续深耕形成的技术底蕴，突破多项核心关键技术，自主研发并掌握了多品类功能性先进粉体材料的生产能力，是全球少数同时掌握火焰熔融法、高温氧化法和液相制备法生产工艺的企业，形成了以硅基氧化物、铝基氧化物产品为基础，多品类规格齐备的产品布局，在稳定供应能力、产品性能、规模、技术上具有行业领先优势。

公司通过自主创新形成了涵盖原料设计、颗粒设计、复合掺杂、高温球化、颗粒分散、液相制备、燃烧合成、晶相调控、表面修饰等核心技术，实现了向全球高端市场突破的跨越式发展，公司已陆续攻克先进封装、新一代高频高速覆铜板、高导热材料等场景用功能性填料的技术难关，成为高性能处理芯片、高性能服务器、高导热材料等尖端领域关键材料供应商。

公司承担了科技部国家重点研发计划、江苏省战略性新兴产业发展专项；完成多项江苏省科技成果转化项目和国家、省级技术革新项目，多项产品被认定为国家重点新产品和江苏省高新技术产品。公司建成并拥有国家特种超细粉体工程技术研究中心硅微粉产业化基地、国家博士后科研工作站、江苏省石英粉体材料工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省博士后创新实践基地、江苏省先进级智能工厂、江苏省无机非金属功能性粉体材料工程研究中心和电子封装用石英粉体材料新兴产业标准化试点等称号。

### (3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，随着 AI 大模型、高性能计算及高速通信等终端应用的迅猛发展，功能性先进粉体材料在先进封装、高性能电子电路基板、导热材料等下游领域中的战略地位从传统填料向核心材料转变，价值量正快速提升。公司持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC 等）封装、异构集成先进封装（Chiplet、HBM 等）、新一代高频高速覆铜板（M8、M9、M10 等）、新能源汽车用高导热材料、先进毫米波雷达等下游应用领域的先进技术，深化纳米级球形二氧化硅、高性能球形二氧化钛等功能性先进粉体材料的研究开发及应用推广，持续推出多种规格、低 CUT 点、表面修饰、Low  $\alpha$  微米/亚微米球形二氧化硅、低钠球形氧化铝粉，Low  $\alpha$  球形氧化铝、高频高速覆铜板用低损耗/超低损耗/极低损耗球形二氧化硅，新能源汽车用高导热微米/亚微米球形氧化铝等产品，持续加强功能性粉体材料的研究开发，技术储备二十余年的液相制备球形二氧化硅也正受益于高性能高速基板的发展机遇，产品认证速度不断加快。随着下游应用领域对高性能材料需求持续提升，公司产品结构有望进一步改善，从而推动经营质量不断提升。

在新产业方面，先进封装产业呈现加速渗透态势，2.5D/3D 等封装技术快速发展，推动具有精准大颗粒管控、更低 CUT 点、更加紧密填充、更低的放射性含量、高导热性的球形二氧化硅、球形氧化铝等功能性先进粉体材料市场需求，公司产品已成为先进封装技术迭代的关键配套材料，市场前景广阔。新业态方面，产业链协作更为深入，公司持续深化与国内外领先的集成电路封装材料、高性能电子电路基板、导热材料厂商的战略合作，凭借多品类产品矩阵为产业链提供全面的材料解决方案，推进新产品验证，功能性先进粉体材料在客户端应用的价值量正显著提升。新模式方面，公司紧抓下游应用领域市场升级的机遇，在优势领域提升市场份额的同时大力推进高性能产品研发与市场拓展，高性能产品营收占比快速增长，产品结构持续优化。未来随着全球 AI 基础设施建设、高速通讯、汽车电子等市场需求的增长，公司将深化技术创新与市场拓展，充分受益于全球高性能粉体材料市场的发展。

## 3、公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	2,260,404,866.18	1,971,962,660.24	14.63	1,754,701,349.09
归属于上市公司股东的净资产	1,705,562,261.94	1,507,675,837.88	13.13	1,347,439,223.00
营业收入	1,115,503,534.99	960,360,374.93	16.15	711,682,420.08
利润总额	334,233,152.74	286,188,151.77	16.79	197,361,403.62
归属于上市公司股东的净利润	292,644,734.72	251,374,413.14	16.42	173,994,421.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,214,795.06	226,912,895.41	16.44	150,270,057.37
经营活动产生的现金流量净额	255,480,449.95	254,708,483.84	0.30	246,948,264.23
加权平均净资产收益率(%)	18.38	17.81	增加0.57个百分点	13.60
基本每股收益(元/股)	1.21	1.04	16.35	0.94

稀释每股收益 (元/股)	1.21	1.04	16.35	0.94
研发投入占营业收入的比例(%)	5.75	6.29	减少0.54个百分点	6.66

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	238,689,614.37	280,567,827.96	304,582,947.23	291,663,145.43
归属于上市公司股东的净利润	63,037,699.67	75,608,897.31	81,377,731.20	72,620,406.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,612,076.79	68,950,659.58	75,283,256.56	61,368,802.13
经营活动产生的现金流量净额	21,460,569.62	21,394,338.81	89,431,841.01	123,193,700.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4、 股东情况

### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							11,438
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							11,381
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

广东生益科技股份有限公司	12,963,000	56,173,000	23.26	0	无		境内非国有法人
李晓冬	11,245,597	48,730,920	20.18	0	无		境内自然人
江苏省东海硅微粉厂	9,722,250	42,129,750	17.45	0	无		其他
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	650,410	3,689,194	1.53	0	未知		未知
刘春昱	750,700	3,402,000	1.41	0	未知		境内自然人
阮建军	629,939	2,866,025	1.19	0	无		境内自然人
曹家凯	518,520	2,246,920	0.93	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	573,696	1,340,634	0.56	0	未知		未知
王松周	146,000	1,306,000	0.54	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	83,840	1,290,194	0.53	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本公告披露之日，李晓冬持有江苏省东海硅微粉厂 100%股份。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

#### 存托凭证持有人情况

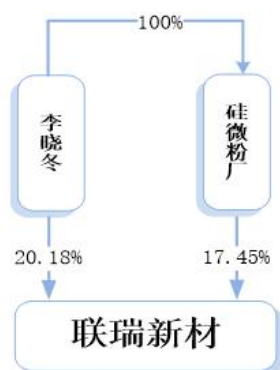
适用 不适用

#### 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

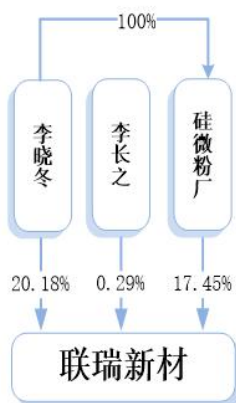
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

### 5、公司债券情况

适用 不适用

## 第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入为 111,550.35 万元，较 2024 年同期增长 16.15%。归属于上市公司股东的净利润 29,264.47 万元，较 2024 年同期增长 16.42%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用